

证券代码：688449

证券简称：联芸科技

# 联芸科技（杭州）股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>2026年一季度电话会议</u> ）
参与单位名称	财通基金、创金合信基金、景顺长城基金、国联基金、中邮证券、长盛基金、正圆投资、光大永明、天弘基金、泰康基金、泰康资产、新华基金、华商基金、英大资产、国金基金、国信证券、华泰证券、招商证券、麦格理资本
时间	2026年04月28日15:00-16:00
地点	公司会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	财务总监、董事会秘书：钱晓飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1.公司2026年一季度各业务板块的营收拆分情况如何？各产品线增长情况怎样，业务占比是否延续2025年的趋势？</b></p> <p>答：2026年一季度市场环境呈现积极态势，公司PCIe3.0和PCIe4.0产品营收同比增长，其中PCIe3.0产品同比大幅增长。SATA产品层面，公司消费级SATA同比小幅下降，环比小幅上涨；企业级SATA同比大幅上涨。同时，公司PCIe 5.0四通道产品和UFS 3.1产品一季度实现量产出货，有望成为公司新的增长点。</p> <p><b>2.公司定向增发预案的后续推进计划是怎样的？本次定增的募集资金用途是什么？</b></p> <p>答：本次定增的募集资金总额为20.62亿元，重点投向企业级PCIe Gen6/Gen7、消费级PCIe Gen6及UFS 5.0等新一代存储主控芯片，完善公司消费级、企业级和嵌入式三大核心市场的全栈产品布局。剩余</p>

	<p>资金用于补充流动资金，以满足公司业务发展对营运资金的需求，优化资本结构，保障公司主营业务持续稳健发展。推进节奏方面，本次预案已于2026年4月9日通过董事会审议，将于2026年5月11日提交股东会审议，待股东会审议通过后，公司将尽快推进申报准备工作；同时结合定增整体推进节奏，逐步有序开展意向投资者的沟通与初步对接工作，合理统筹相关沟通安排。</p> <p><b>3.公司2026年的营收预期是多少？有哪些增长驱动因素？</b></p> <p>答：公司营收增长受多方面驱动因素影响：1. 消费级产品通过迭代升级带动单颗芯片价值量提升，叠加市占率增长，带动营收稳健增长；2. 一季度公司UFS3.1产品量产出货，随着手机客户的不断导入，逐步贡献营收；3. 企业级业务层面，公司企业级PCIe5.0固态硬盘主控芯片已经进入量产测试阶段，为后续年度增长奠定基础。</p> <p><b>4.公司嵌入式主控芯片的布局和进展如何？什么时候能对营收产生贡献？</b></p> <p>答：公司将嵌入式UFS主控芯片定位为继SSD主控后数据存储主控领域的第二增长曲线。目前，公司首款UFS3.1嵌入式主控芯片已量产出货，26年开始贡献营收。UFS2.2、UFS4.1产品研发稳步推进。公司将依托SSD主控的技术积累与客户渠道，打造独立第三方嵌入式存储主控的核心竞争力。</p> <p><b>5. 公司合作的主要封装厂有哪些？封装厂涨价对公司成本端的影响有多大？</b></p> <p>答：公司目前主要与位于中国大陆及中国台湾地区的主流封装厂进行合作，并与其保持了长期稳定的合作关系。截至目前，封装价格较为稳定；若下半年原材料价格持续上行，封装厂可能会适度调价。但是，由于封装成本在公司整体BOM成本中占比较低，即便后续有所调整，对芯片成本端的整体影响较小。</p> <p><b>6. 公司当前的业务重心及未来的业务布局是什么？</b></p> <p>答：公司作为Fabless集成电路芯片设计企业，始终秉持“产品技术创新和客户至上”的核心经营理念，持续聚焦数据存储主控芯片与AIoT信号处理及传输芯片两大核心赛道。具体到数据存储主控芯片领域，公司近两年将重点投入嵌入式存储主控及企业级存储主控的研发及产业化，抢抓AI驱动下存储产业升级战略窗口期，持续完善产品矩阵、提升核心竞争力。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>

附件清单（如有）	无
日期	2026年4月28日